

ひとわざ(一技)名: 微細穴加工機(ビサイア)を生み出した加工技術
DTF M/C

1. 概要(200字目安)

職人技であった $\phi 0.3$ 以下の微細穴加工を機械化したいとの発想から、旋盤型微細穴加工機「ビサイア」が生まれました。

穴あけのサイズは $\phi 0.03 \sim 0.3\text{mm}$ 、アスペクト比はMAX170を実現。

ドリル軸にスラストセンサーとトルクセンサーを組み込み、ドリルの欠損を防ぎます。

弊社の高精度加工技術が作り出した機械です。

写真・図(要点説明)



ビサイアに活かされている技術

- ・ 静圧軸受を搭載し、主軸の振れ精度は1ミクロン以下です。
- ・ ドリル軸に組み込んだ特殊センサが熟練技能者の感覚を数値化し、データベース化しました。
- ・ 加工条件はタッチパネルから選択するだけ

ダイヤ精機のメカトロ技術が満載された機械です。

2. 企業概況

会社名	(株) ダイヤ精機製作所	代表者名	小口 裕司
		窓口担当	田中 貴
事業内容	精密機械器具製造	U R L	http://www.daiva.co.jp
主要製品	精密工作機械及びツール類、高精度スピンドル、各種コレットチャック・ガイドブッシュ&ユニット		
住所	〒394-0084 長野県岡谷市長地片間町1-4-20		
電話/FAX	0266-26-1187/26-1188	E-mail	takashit3234@daiva.co.jp
資本金(百万円)	40	設立年月日	昭和26年5月
		売上(百万円)	1200
		従業員数	150

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績)

① ISO9001 2000年認証取得、ISO14001 2002年認証取得

② 自社製品: 微細穴加工機(ビサイア)、第1回新機械振興賞中小企業庁長官賞他受賞多数